

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-145753

(43)Date of publication of application : 29.06.1987

(51)Int.Cl.

H01L 23/28

H01L 23/34

(21)Application number : 60-287346

(71)Applicant : DAIICHI SEIKO KK

(22)Date of filing : 19.12.1985

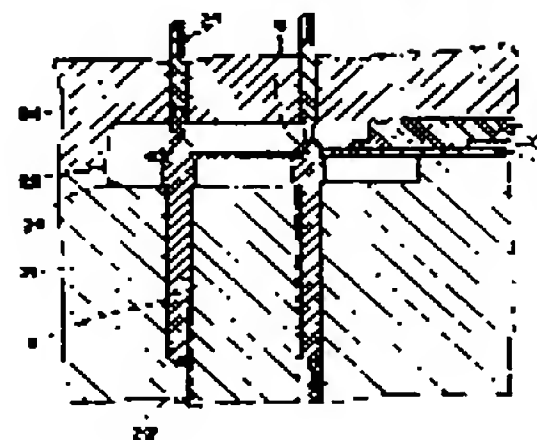
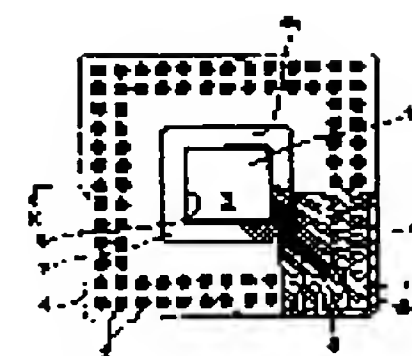
(72)Inventor : KONISHI AKIRA
WAKANO TERUO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the thickness, to enhance the density, to decrease the cost and to increase the number of pins of a semiconductor device by sealing and integrating a circuit substrate, the bases of input/output pins engaged fixedly with the substrate and the peripheral edge of a heat sink plate disposed on the substrate in a resin sheath.

CONSTITUTION: The heads 2a of stepped external connection input/output pins 2 are inserted into pinholes 9 of a substrate 1 formed with a wiring circuit 8 on an insulating substrate body 7, the body 7 and the circuit 8 are held between the heads 2a and the steps 2b, the pins 2 are fixed to the substrate 1 and electrically connected with the circuit 8. Then, the substrate 1 is set in a cavity 23 of a lower mold 21, a heat sink plate 3 is set to cover the hole 6 of the substrate 1, and an upper mold 24 is moved down to close the molds. Then, heat resistant resin is injected from a gate 26 into the cavity 23 of the mold, sealed and molded. Then, a plug-in package is removed from the molds, a semiconductor element is mounted on the plate 3 through the hole 6 of the substrate 1 exposed in the recess 4a of a sheath 4, the external connection terminals are connected with the circuits 8 to complete a semiconductor device.



〔19〕中华人民共和国专利局



〔12〕发明专利申请公开说明书

〔11〕CN 86 1 05249 A

〔51〕Int.Cl.⁴

H01N 23/02

H01N 23/12

6 A
CN 86 1 05249

〔43〕公开日 1987年2月11日

〔21〕申请号 86 1 05249

〔22〕申请日 86.8.16

〔30〕优先权

〔32〕85. 8.16 〔33〕日本 〔31〕180901 / 1985

〔32〕85. 8.16 〔33〕日本 〔31〕180902 / 1985

〔32〕85.12.19 〔33〕日本 〔31〕287346 / 1985

〔71〕申请人 第一精工株式会社

地址 日本京都府京都市伏见区桃山町根来
12-4

〔72〕发明人 小西昭 若野辉男

〔74〕专利代理机构 中国专利代理有限公司

代理人 肖春来

〔54〕发明名称 半导体器件及其制造

〔57〕摘要

一种半导体器件,其中有一或多个半导体芯片装进插入式封装里。封装要和印刷接线基片、引线的头部和为附连半导体芯片的散热装置一起模制成封装的整体部分。散热装置的一个表面要在封装的一个底面露出来,并且要将半导体芯片装在面朝着基片切口的散热装置的其他表面上。

242/87102195/43

北京市期刊登记证第1405号

图9 从图8 X—X线取出的放大截面图，

图10 是图8 半导体模制件的局部放大图，其中有基片和装入的散热装置，

图11 是体现本发明的另一形式的半导体器件的横截面图，

图12 仍然是体现本发明的另一形式的半导体器件的横截面图，

图13 是本发明的半导体器件的局部放大的横截面图，

图14 是本发明的半导体器件的局部放大的横截面图，

图15 是体现本发明的另一形式的半导体器件的透视图，局部拆开以展示其内部结构，

图16 体现本发明的另一形式的半导体器件的透视图，局部拆开展示其内部结构，

参考图1至4，展示了根据本发明的半导体器件的插入式封装，它包括一块印刷接线基片1，多根引线2，附连半导体器件用的散热装置3以及封装体4，封装体与基片1、引线头部2和散热装置3一起模制以作为封装的整体部分。封装体4的上表面盖有一层防水蒸汽的阻挡材料5，例如环氧树脂或聚酰亚胺树脂以避免水蒸汽渗透入封装的内部。

如图2所示，印刷接线基片1包含由聚酰亚胺树脂做成的绝缘薄膜7，其下底面具有由导体图样8组成的印刷接线。基片1的中部有一切口6和多个附连引线的通孔9。导体图样8有作为其中的整体部分的8a，它和通孔9是同心圆结构并环绕通孔，以保证引线2和导体图案之间的电气连接。

每条引线2固定到印刷接线基片1的做法是先把其体颈的无头端插入通孔直到套环2b与基片接触为止，然后将体颈的突出端缢打成半球形的头2a。如图1所示，引线2电气连接到各自的图案8并向下伸延。

在散热装置3的一边有作附连半导体芯片用的凹槽10，其尺寸近似等于切口的尺寸。散热装置3安排在基片1的上面，以使凹槽10面朝切

图 1

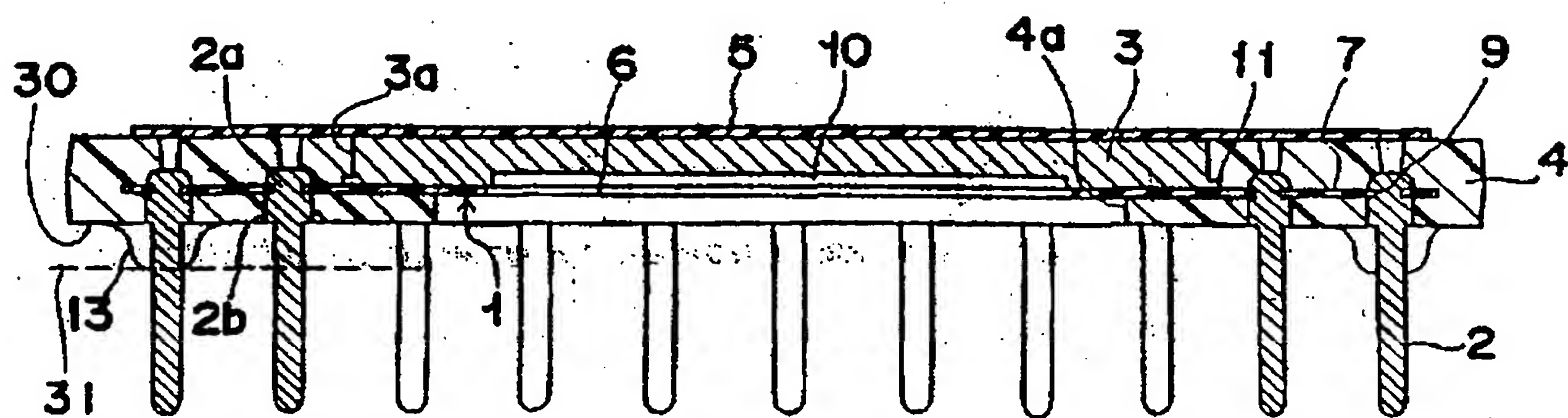


图 2

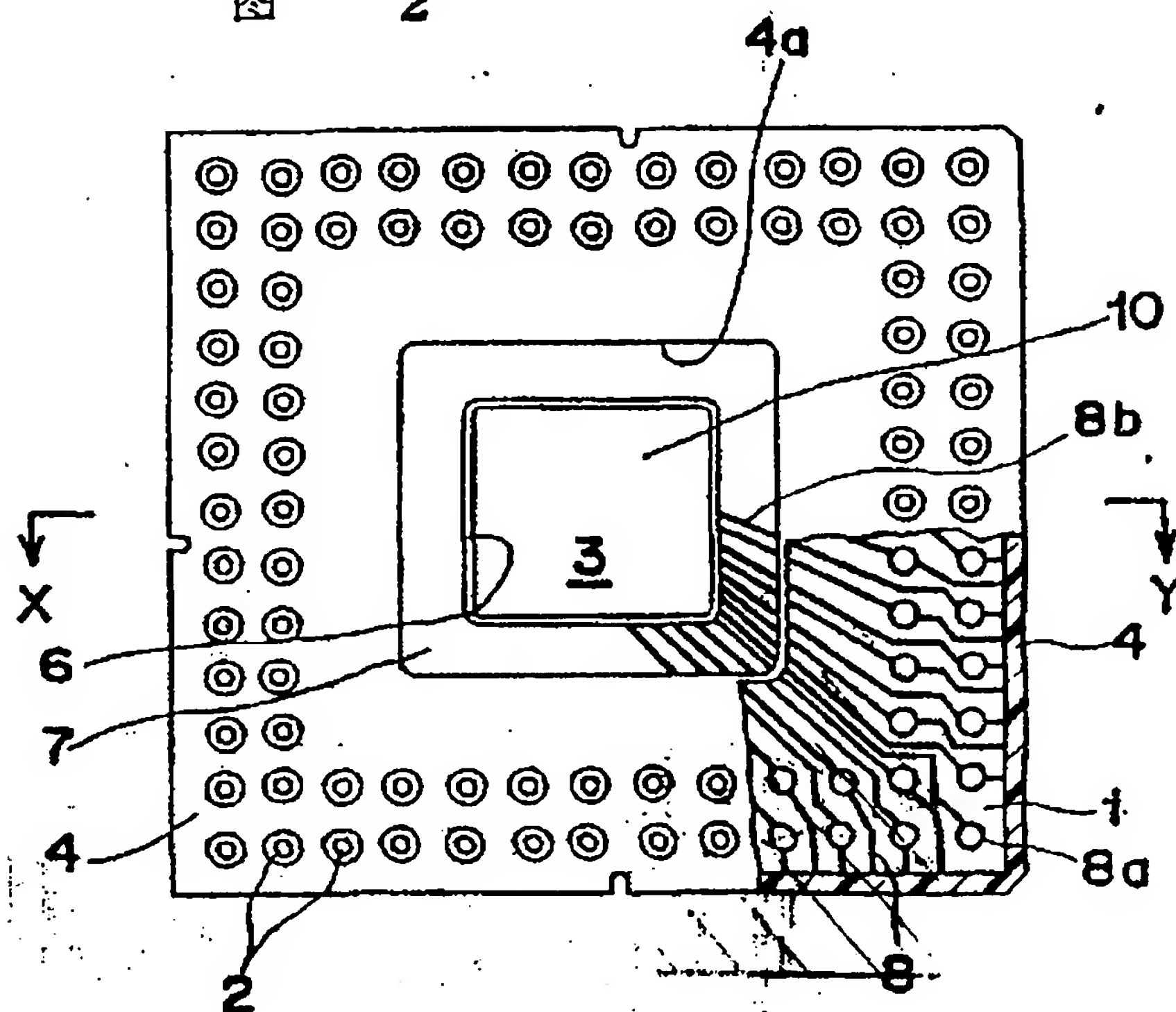


图9 从图8 X—X线取出的放大截面图；

图10 是图8 半导体模制件的局部放大图，其中有基片和装入的散热装置；

图11 是体现本发明的另一形式的半导体器件的横截面图，

图12 仍然是体现本发明的另一形式的半导体器件的横截面图，

图13 是本发明的半导体器件的局部放大的横截面图，

图14 是本发明的半导体器件的局部放大的横截面图，

图15 是体现本发明的另一形式的半导体器件的透视图，局部拆开以展示其内部结构；

图16 体现本发明的另一形式的半导体器件的透视图，局部拆开展示其内部结构；

参考图1至4，展示了根据本发明的半导体器件的插入式封装，它包括一块印刷接线基片1，多根引线2，附连半导体器件用的散热装置3以及封装体4，封装体与基片1、引线头部2和散热装置3一起模制以作为封装的整体部分。封装体4的上表面盖有一层防水蒸汽的阻挡材料5，例如环氧树脂或聚酰亚胺树脂以避免水蒸汽渗透入封装的内部。

如图2所示，印刷接线基片1包含由聚酰亚胺树脂做成的绝缘薄膜7，其下底面具有由导体图样8组成的印刷接线。基片1的中部有一切口6和多个附连引线的通孔9。导体图样8有作为其中的整体部分的8a，它和通孔9是同心圆结构并环绕通孔，以保证引线2和导体图案之间的电气连接。

每条引线2固定到印刷接线基片1的做法是先把其体颈的无头端插入通孔直到套环2b与基片接触为止，然后将体颈的突出端缝打成半球形的头2a。如图1所示，引线2电气连接到各自的图案8并向下伸延。

在散热装置3的一边有作附连半导体芯片用的凹槽10，其尺寸近似等于切口的尺寸。散热装置3安排在基片1的上面，以使凹槽10面朝切